

电连技术股份有限公司 关于建广广辉基金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为响应国家号召，抓住当前集成电路产业重组整合的良机，通过产业项目投资，带动产业链发展并创造良好的投资回报，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京建广资产管理有限公司、格科微电子（上海）有限公司、上海瓴煦企业管理中心（有限合伙）共同合作，投资设立了建广广辉（德州）股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“建广广辉”或“基金”）。建广广辉出资总额为人民币 227,378,712.50 元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 21,643,410.64 元，出资比例为 9.5187%。本基金的投资标的为瓴盛科技有限公司（以下简称“瓴盛科技”）7.042% 股权。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 15 日及 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-096）及《关于参与投资设立的股权投资合伙企业完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-130）。

近日，公司收到基金执行事务合伙人北京建广资产管理有限公司的通知，截至本公告日，各合伙人已按照合伙协议完成出资，基金已完成募集，并已投向瓴盛科技。

本次基金再投资事项无须经公司董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、企业名称：瓴盛科技有限公司

统一社会信用代码：91520900MA6H0A7N30

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：成都市双流区东升街道成都芯谷产业园区集中区内

法定代表人：李滨

注册资本：298460.64 万元人民币

成立时间：2018-05-16

经营期限：2018-05-16 至 2038-05-15

经营范围：与芯片解决方案有关的设计、包装、测试、客户支持及销售；与 PCB A 相关的设计、测试、设计协助及销售；以及芯片和 PCBA 相关的技术开发、技术许可、技术咨询、技术服务及软件开发。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、业务介绍

主要从事智能物联网、移动通信手机芯片及其衍生品的研发，下游应用行业主要为移动通信、物联网、人工智能、的研发与整合，专注于设计和销售以高通核心技术支持研发的蜂窝通讯和智能物联网 SOC 芯片产品。

半导体芯片产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家战略性的、基础性和先导性产业，当前和今后一段时期是我国半导体芯片产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。瓴盛科技对标的行业紧紧围绕泛 5G 未来的广泛应用，具有非常好的产业前景，符合国家产业政策的鼓励方向，有利于提升国家整体的半导体芯片的能力及水平。成立以来，瓴盛科技逐步积累了较多的客户，第一颗 AIoT 物联网芯片已经量产，已经在国内的众多头部客户中应用，在 AI 视觉及物联网应用的领域及智能手机 SOC 类型的芯片也即将发布，这些产品陆续推出将极大提升瓴盛科技的市场空间及业务量。

三、投资协议的主要内容

基金以现金的形式对瓴盛科技出资 210,189,500 元人民币，占瓴盛科技注册资本的 7.0425%。

四、基金本次对外投资的目的及对公司的影响

公司的前端研发已经与国际知名的 IC 设计大厂有着较好的合作背景，在国产自主的产业政策背景引导下，借本次投资的机会，有利于公司扩大产品在国内、国外电子元件产业循环的规模，形成与瓴盛科技良性业务协同互动，有利于公司增强技术能力和水平，拓展海外优质客户的同时，拓展更多的行业应用，扩大业务的规模，丰富产品的类型及提升产品组件价值量。希冀在未来泛 5G 时代占领更高更好的战略制高点，提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司业绩可持续、稳定增长。

五、基金本次对外投资存在的风险及应对措施

基金本次对外投资存在因时间因素或行业环境发生重大变化，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。为此，公司将密切关注国家的相关政策法规和标的公司的经营情况，有效借助公司的优势资源来支持标的公司的发展，努力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日